

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：郭人榮
電子信箱：michael2412@must.edu.tw
聯絡電話：(03)559-3142分機3270、3162
傳真電話：(03)5595142

受文者：遠東科技大學

發文日期：中華民國115年1月9日
發文字號：明新（半）字第1150000265號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：1151200004_1_ATTACH1.pdf 附件2. 明新科技大學114學年度教師產業研習活動海報1份 (1151200004_1_ATTACH1.pdf、1151200004_2_ATTACH2.jpg)

主旨：有關本校辦理114學年度教師產業研習「半導體封裝測試與設備實務應用」培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，課授封裝與測試的專業知識及先進封裝所衍生的技術挑戰。在實務應用先規劃學員如何操作晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化封裝設備。爾後再訓練學員如何設置功率IC測試系統、檢修電路、測試程式開發及使用晶圓針測機，讓學員充分了解IC元件封裝到測試等一系列核心專業職能與實務應用，檢附研習課程之活動簡章(附件1)及活動海報(附件2)。

二、研習相關資訊：

(一)本研習課程分兩梯次研習時段：

1. 第一梯次：115年1月19日(星期一)至115年1月30日(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

2. 第二梯次：115年7月13日（星期一）至115年7月24日（星期五），共10天，上午8時30分至下午4時30分。

（二）研習地點：本校電子工程系館-210教室、半導體技術中心。

（三）參加培訓人數30人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

（一）報名時間：即日起至115年1月14日止。

（二）報名網址：<https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9>

四、報名洽詢：本校半導體技術中心辦公室郭人榮助理，電話：(03)559-3142分機3270、3162。

正本：全國高級中等學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、電子工程系、產學及研究推動中心

電文
2025/01/09
14:51:26
交換

裝



36
訂

線

明新科技大學114學年度教師產業研習

半導體封裝測試與設備實務應用培訓營課程簡章

主辦單位	明新科技大學			
第一梯次(10天，共70小時)				
日期	時間	培訓內容	講員	服務機構及職稱
1/19 (一)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	半導體製程的發展與挑戰 認識晶圓切割機組成與功能	呂明峯 何信松	明新科技大學 電子工程系教授兼校長 力成科技公司資深工程師
1/20 (二)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	半導體封裝綜覽 晶圓切割機人機介面參數設定	蔡天寶 何信松	力成股份有限公司 封裝製造暨設備整合處處長 力成科技公司資深工程師
1/21 (三)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	半導體構裝技術的演變 晶圓切割機實務程序操作	羅勉成 何信松	世芯電子公司 專案顧問 力成科技公司資深工程師
1/22 (四)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	基礎半導體封裝概論 認識固晶機組成與功能	趙守嚴 林賢昇	明新科技大學 電子工程系教授 力成科技公司資深工程師
1/23 (五)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	半導體封裝第一階層連接方式 固晶機人機介面參數設定	趙守嚴 林賢昇	明新科技大學 電子工程系教授 力成科技公司資深工程師
1/26 (一)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	3D 封裝製程 固晶機實務程序操作	趙守嚴 林賢昇	明新科技大學 電子工程系教授 力成科技公司資深工程師
1/27 (二)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	先進封裝工程概論 認識打線機組成與功能	趙守嚴 黃志賢	明新科技大學 電子工程系教授 力成科技公司資深工程師
1/28 (三)	8:30 – 12:00 13:00 – 16:30	晶圓級封裝製程 打線機人機介面參數設定	趙守嚴 黃志賢	明新科技大學 電子工程系教授 力成科技公司資深工程師

1/29 (四)	8:30 – 12:00	面板級封裝製程	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系教授
	13:00 – 16:30	打線機實務程序操作	黃志賢	力成科技公司資深工程師
1/30 (五)	8:30 – 12:00	先進封裝的發展趨勢	王欽宏	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組組長
	13:00 – 16:30	認識 QFN 封裝設備組成與功能	鄭國偉	廣化科技股份有限公司 業務處經理

第二梯次(10 天，共 70 小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
7/13 (一)	8:30 – 12:00	QFN 封裝設備人機介面參數設定	陳慶恩	廣化科技公司 資深研發工程師
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備操作能力評量	陳慶源	廣化科技股份有限公司 資深工程師

7/14 (二)	8:30 – 12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鉉	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
	13:00 – 16:30	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技公司資深工程師
7/15 (三)	8:30 – 12:00	溫室低碳減排	洪君伯	明新科技大學 工業工程與管理系副教授
	13:00 – 16:30	黏晶機操作能力評量	林賢昇	力成科技公司資深工程師
7/16 (四)	8:30 – 12:00	IC 封裝產業環境汙染處理	江鍇帆	力成股份有限公司 工安二部副部經理
	13:00 – 16:30	打線機操作能力評量	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/17 (五)	8:30 – 12:00	封裝產業廠務系統介紹	盧麒泰	力成股份有限公司 廠務副部經理
	13:00 – 16:30	基礎半導體測試概論	陳啟文	明新科技大學 電子工程系教授兼 半導體學院院長
7/20 (一)	8:30 – 12:00	測試系統基礎架構介紹	沈添賜	明新科技大學 電子工程系助理教授
	13:00 – 16:30	元件直流參數量測	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
7/21 (二)	8:30 – 12:00	自動化測試機台簡介及內部測試模組架構	周志忠	美達科技股份有限公司 技術支援部資深工程師
	13:00 – 16:30	自動化測試機台內部測試模組使用指令介紹	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
7/22 (三)	8:30 – 12:00	IC 元件特性與量測介紹	周志忠	美達科技股份有限公司 技術支援部資深工程師
	13:00 – 16:30	測試程式開發--整合型多工 IC 測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
7/23 (四)	8:30 – 12:00	測試程式開發--電源管理元件測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
	13:00 – 16:30	測試程式開發能力評量--電源管理元件測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
7/24 (五)	8:30 – 12:00	自動晶圓探針台介紹及實務程序操作	沈添賜	明新科技大學 電子工程系助理教授
	13:00 – 16:30	自動晶圓探針台介紹及實務操作評量	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理

第一梯次：

115年1月19日(一)至115年1月30日(五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分

第二梯次：

115年7月13日(一)至115年7月24日(五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分

開課日期

開課地點	明新科技大學半導體人才培育基地、電子工程系館-210 教室
合作機構	明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組 力成科技股份有限公司 廣化科技股份有限公司 美達科技股份有限公司
參與對象	高中職及大專院校教師
收費標準	免費
招生人數	招生人數 30 人
報名網址	<p>https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>活動報名 QR Code</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>活動公告 QR Code</p> </div> </div>



114學年度教師產業研習 半導體封裝測試與 設備實務應用培訓營

課程簡介

本課程由專家學者與業師共同授課，課授封裝與測試的專業知識及先進封裝所衍生的技術挑戰。在實務應用先規劃學員如何操作晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化封裝設備。爾後再訓練學員如何設置功率IC測試系統、檢修電路、測試程式開發及使用晶圓針測機，讓學員充分了解IC元件封裝到測試等一系列核心專業職能與實務應用。

課程時間 / 地點

第一梯次

115/01/19(一)至115/01/30(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

第二梯次

115/07/13(一)至115/07/24(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

電子工程系館-210教室

明新科技大学半導體人才培育基地

合作廠商

- 明志科技大學
教師產業研習研究專案辦公室
- 工研院電子與光電系統所
異質整合智能系統組
- 力成科技股份有限公司
- 廣化科技股份有限公司
- 美達科技股份有限公司

參與對象/報名資訊

高中職及大專院校教師

報名時間：即日起至115年1月14日

報名網址如下：免費・名額30人

<https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9>



聯絡人

明新科技大学半導體學院

半導體人才培育基地辦公室

郭人榮助理

TEL : 03-5593142 #3270、3162